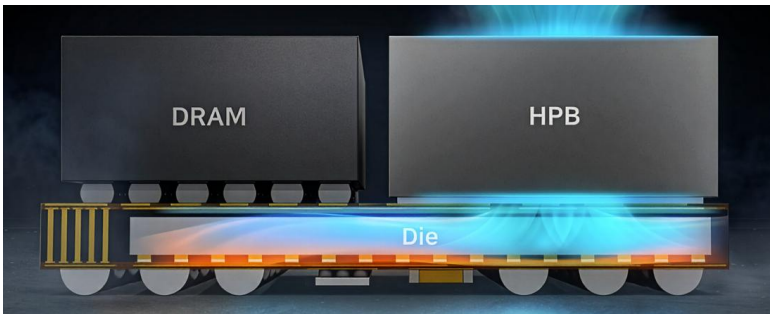
UNDER PLANNING

LTEC Corporation
Your most experienced partner in IP protection

プロセッサ: Samsung Exynos 2600構造解析レポート企画

Exynos 2600



HeatPassBlock

引用：https://semiconductor.samsung.com/processor/mobile-processor/exynos-2600/

レポート概要

Samsungは、近年のExynosシリーズにおける性能・発熱課題への対応として、次世代SoC「Exynos 2600」を開発しました。

これは、同社初の2nm GAA（Gate-All-Around）プロセスを採用した高性能チップであり、2026年リリース予定の「Galaxy S26」シリーズに搭載が見込まれています。

Exynos 2600では、高性能化と熱安定性の両立を目指し、新冷却構造「HPB（ヒートパスブロック）」を導入しています。これにより、SoCから発生する熱をより効率的に筐体外へ逃がすことが可能となり、熱集中の抑制や局所的な温度上昇の緩和が期待されます。

本解析では、Exynos 2600のHPB~SoC間について断面から接続状態を明らかにし、SoCから外部までの熱伝達経路を推定する内容を予定しております。

製品特徴

・2nm GAAプロセス採用（Samsung初）による電力効率と性能の両立

・新構造「HPB」により熱抵抗を最大16%低減

解析内容・レポート価格

・断面観察によるHPBとSoCの接続関係を確認

・各層材料の成分分析(EDX分析)

・各層の熱抵抗をモデル化してSoCから外部までの熱伝達経路を推定

予定価格：670,000円（税別）　納期：企画成立後1ヶ月

Report No.25L-0989-1 Release day:未定

株式会社エルテック
〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡 4丁目42-8 TEL.072-787-7385
mail contact2@ltec.biz
HP https://www.ltec-biz.com/